



新闻动态

- ▶ [图片新闻](#)
- ▶ [头条新闻](#)
- ▶ [综合新闻](#)
- ▶ [学术活动](#)
- ▶ [科研动态](#)
- ▶ [通知公告](#)
- ▶ [业内信息](#)
- ▶ [合作交流](#)
- ▶ [科研项目资金管理](#)

现在位置：[首页](#) > [新闻动态](#) > [综合新闻](#)

第三届全球传感器高峰论坛会议在合肥顺利举行

2016-09-26 | 编辑： | [【大中小】](#) [【打印】](#) [【关闭】](#)

2016年9月22日-23日，第三届全球传感器高峰论坛暨中国物联网应用峰会在合肥天鹅湖大酒店拉开帷幕。本届全球传感器高峰论坛暨中国物联网应用峰会由合肥市人民政府、中国科学院微电子研究所、中国科学技术大学主办，合肥高新技术产业开发区管委会、中国科学院物联网研究发展中心、合肥市集成电路产业技术创新战略联盟、合肥市半导体产业发展有限公司承办。

这是一次国际性的会议，来自国家、省、市相关领导，国内外知名传感器及物联网行业的专家学者、60多家传感器领域的参展商、应用厂商、投资机构等500余家单位1000多名集成电路大咖齐聚合肥，围绕最前沿的科学技术及产品应用，展开了一系列的讨论和研究，为传感器的发展和物联网的应用，开拓视野、观点碰撞。



本届峰会由中国科学院微电子研究所副所长，中国科学院物联网研究发展中心常务副主任陈人鹏、CCTV证券资讯频道《聚焦新三板》制片人、主持人李颖共同主持。



中国科学院微电子研究所所长、中国科学院物联网研究发展中心主任叶甜春，国家集成电路产业投资基金股份有限公司总裁丁文武、工业和信息化部电子信息司集成电路处处长任爱光、合肥市副市长王翔等重要领导出席了论坛开幕式并致辞。



叶甜春说，希望以此此次活动为平台，让更多的思想在这里碰撞出火花，助推全球传感器共繁荣的信息化、智能化新纪元。



丁文武说，希望大家以此次会议为平台，共同探讨物联网技术和应用催生的新科技、新产业、新经济，共商发展策略。

任爱光说，希望大家针对国内外产业现状和存在问题，结合区域特征和优势，构建特色产业架构和形态，实现产业化集群式发展和行业振兴。

王翔说，合肥市集成电路产业发展基础已经具备了发展传感器和物联网产业的实力，将努力打造中国IC之都。希望与会专家、企业家们为合肥集成电路产业发展献计献策。

会上，还举行了中国合肥高新区“芯之城”首批项目签约仪式，国际领先的IC设计服务公司及一站式服务供应商?芯芯半导体（上海）有限公司分别与Synopsys、Cadence、Mentor、北京安创空间科技有限公司（ARM子公司）等国际IC设计产业巨头，就合作设立芯芯集成电路商业孵化器签署合作协议。



主论坛上，合肥高新技术产业开发区管委会主任助理王伟，芯原股份有限公司创始人、董事长兼总裁戴伟民，中芯聚源股权投资管理有限公司总裁孙玉望，工信部电子元器件行业发展研究中心总工程师郭源生，江苏多维科技有限公司董事长兼首席执行官薛松生，中微半导体设备（上海）有限公司全球事业群集团副总裁朱新萍，东京大学教授须贺惟知，北京北方微电子公司副总裁刘韶华等演讲嘉宾展望了全球传感器及物联网发展趋势，呈现了半导体产业进入升级期、传感器产业跨越发展指导、传感器设备发展迎来新机遇、智慧城市开辟传感器巨大空间等真知灼见，进而有助于我国规划传感器未来十年的发展路线图，加速传感器产业成熟。

本届峰会以一个主论坛暨“全球传感器高峰论坛暨中国物联网应用峰会”议题为中心，附以九大分论坛的形式展开，9月22日下午、9月23日上午举行了九大分论坛：

- 分论坛一：全球传感器研讨会
- 分论坛二：封装测试研讨会
- 分论坛三：VR和AR?可穿戴?智能家居?智能硬件研讨会
- 分论坛四：“大联大”无人驾驶?新能源汽车?车联网研讨会
- 分论坛五：物联网创新方案暨开发者创客成果论坛
- 分论坛六：工业4.0?人工智能?机器人?3D打印研讨会
- 分论坛七：大数据?金融支付?金融互联网研讨会
- 分论坛八：智慧养老?移动医疗研讨会
- 分论坛九：CCTV证券资讯频道《聚焦新三板》物联网专场对接会





九大分论坛的召开汇集世界各国100多位专家的“真知灼见”，展望未来万亿级“宏伟蓝图”。峰会邀请的来自中华人民共和国工业和信息化部、中国科学院微电子研究所、科技部重大专项办公室、工信部电子元器件行业发展研究中心等国内大型科研机构、研究院所的各位专家学者与国内大型企事业单位的代表共聚一堂，共同探讨传感器以及中国物联网产业的发展。展望了全球传感器、中国物联网应用领域未来发展趋势，呈现中国MEMS、传感器、封装测试、VR和AR、智能硬件、无人驾驶、车联网和新能源汽车、3D打印、工业4.0、大数据、金融支付等的产业现状，从而有助于我国规划传感器、物联网应用未来十年的发展路线图，加速产业成熟。

本次峰以独特视角预测发展大势、助谋国内外产业市场。权威专家、原厂高层传道解惑，帮助发散思维、突破行业壁垒、拉近产业链，以应对技术发展、系统集成、以及国内外同业竞争的严苛挑战！

(新闻来源：物联网产业联盟)



附件下载：



中国科学院微电子研究所版权所有 邮编：100029
单位地址：北京市朝阳区北土城西路3号，电子邮件：webadmin@ime.ac.cn
京公网安备110402500036号

